

■正しくお使いください

使用上の注意

全形式共通

●操作時の注意事項

- ・FPCを逆挿入しないようご注意ください。
お客様で設計された接点方向とは逆側にFPCの接触面を向けて挿入すると、端子番号が一致せず、機器が誤動作する恐れがありますので、十分ご注意ください。
- ・FPCは確実に奥まで挿入してください。
接触信頼性を損なう場合があります。
- ・スライダのロックおよび解除操作の際に、過大な力を加えないでください。
コネクタが破損し、接触不良の原因となります。
- ・一度、スライダが外れたものは、使用しないでください。
- ・FPCの挿入・引き抜きは、スライダを解除した状態で実施してください。
次のような操作を行うとFPCの損傷や端子の変形など、接触不良の原因となります。

- (1) スライダをロックした状態で、FPCを引き抜くこと。
- (2) 上下、左右、斜め方向にこじって、FPCを引き抜くこと。

●設計時の注意事項

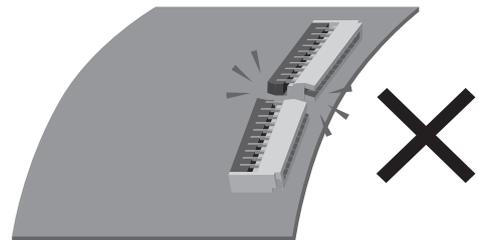
- ・コネクタに直接力が加わらないよう、FPCを引き回してください。
コネクタ付近でFPCが折り曲がった状態やFPCに力が加わる状態でご使用になると、接触不良の原因となります。
- ・FPCに連続的な振動がかかったり、可動したりする機器・箇所へ搭載される場合は、FPCを固定してご使用ください。
- ・当社適合仕様・寸法のFPCをご使用ください。
適合以外のFPC、またはFFCをご使用の場合は、当社までお問い合わせください。
- ・FPCのメッキ仕様は、コネクタのメッキ仕様と同種金属をご使用ください。
- ・鉛フリー仕様のFPC皮膜からウイスカが発生する可能性がありますので、ご使用の際はご注意ください。
- ・メタルマスク厚は、 $t=0.12\sim 0.15\text{mm}$ の範囲でご使用ください。
なお、メタルマスク推奨開口率は、外形寸法図内の基板加工寸法(基準寸法)に対し、90%とします。

●実装時の注意事項

- ・FPCをコネクタに挿入した状態で、実装(リフロー・手はんだ)しないでください。接触不良の原因となります。
 - ・リフロー条件は、当社の仕様範囲内でご使用ください。
ただし、はんだの種類、メーカー、量や基板サイズ、他の実装部材などの条件により変わる場合がありますので、実装状態をご確認の上、ご使用ください。
 - ・手はんだによる実装を行う場合、接触信頼性を確保するため、次の点にご注意ください。
- (1) 手はんだ条件： $350\pm 10^{\circ}\text{C}$ 3 \pm 1秒
 - (2) フラックス上がりの原因となりますので、過度にはんだをつけないでください。
 - (3) 端子変形の原因となりますので、コテ先を実装端子部に強く押し付けしないでください。
 - (4) コネクタの変形の原因となりますので、コテ先がコネクタの実装端子部以外に触れないでください。

●基板実装時の注意事項

- ・基板の反り量にご留意ください。コネクタの平坦度は0.1mm以下ですが、反り量が多い場合、はんだ付け不良の原因となる恐れがあります。
 - ・実装する以前にコネクタに過大な力を加えないでください。コネクタが破損し、接触不良の原因となります。また、実装前にFPCを挿入したり、スライダのロック操作をしないでください。
 - ・次のような作業時は、基板に過大な負荷が加わらないようご注意ください。コネクタが破損し、接触不良の原因となります。
- (1) 多数個取の基板を割る
 - (2) 基板をねじ止める



●保管について

- (1) 保管場所は防塵・防湿を考慮してください。
- (2) アンモニアガス・硫化ガスなどのガス発生源の近くには保管しないでください。

スライドロックタイプのみ

●操作時の注意事項

- ・スライダのロック操作は、スライダの両端、もしくは全体を同時に押さえ、スライダを完全に押しきってください。
スライダが完全に押しきれていない場合、接触不良の原因となります。

●設計時の注意事項

- ・基板設計の際は、スライダのロック解除状態でのスペースや、操作に必要なスペースを確保してください。
- ・形XF2J、形XF2M、形XF2W、形XF3MはFFCをご使用いただけます。適合仕様については仕様書をご確認いただくか、当社までお問い合わせください。